

# 普冉半导体（上海）股份有限公司

## “提质增效重回报”2025 年度方案执行情况 及 2026 年度行动方案的报告

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“普冉股份”）于 2025 年 3 月 31 日披露了《“提质增效重回报”2024 年度方案执行情况及 2025 年度行动方案的报告》，并于 2025 年 8 月 22 日披露了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

2025 年度，公司依据行动方案积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、提升公司市场竞争力、树立良好资本市场形象等方面收获了显著成效。公司在总结 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的基础上，以持续“强化经营质量、培育新质生产力、加大投资者回报”为核心，紧密结合自身发展战略与经营现状，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

### 一、战略纵横推进，内生多元化新产品布局，外延抢占存储新领域先机

公司自 2016 年成立以来，以存储为本，充分发挥自身在特色工艺设计和市场拓展方面的优势，巩固了在非易失性存储器领域的领先地位。2022 年起至今，公司深化主业，形成了 SONOS 和 ETOX 双工艺并行的全容量全系列产品布局，提升了公司在存储领域的市场竞争力。

2022 年，公司提出“存储+”战略，业务向 MCU 及 VCM Driver 模拟芯片等领域延伸。新产品自推出后，公司抓住市场窗口期，实现产品力与商业策略高效协同，使得公司“存储+”系列产品市场份额持续快速提升，第二增长曲线带动公司营业收入及出货量创历史新高。

为增强公司在存储器芯片领域的核心竞争力，进一步丰富产品线，公司于 2025 年 11 月通过现金收购方式，控制珠海诺亚长天存储技术有限公司（以下简称“诺亚长天”）51%股权，将其全资子公司 SkyHigh Memory Limited（以下简

称“SHM”)纳入上市公司合并范围,完成了对 2D NAND 市场的布局。

2025 年,受益于存储芯片市场供给格局的有利变化,以及 AI 服务器、高端手机、通讯网关等终端需求的集中释放带来的结构优化,公司积极拓展市场份额,同时抓住市场供需缺口所带来的产品导入机会,营业收入规模达到历史新高。报告期内,公司实现营业总收入 23.20 亿元,较上年同期增加 28.62%;实现归属于母公司所有者的净利润 2.08 亿元,较上年同期下降 29.03%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1.65 亿元,较上年同期下降 38.67%。净利润变化的主要原因系研发投入增加、规模扩张带来的团队人力成本增加及存货计提减值等。同时,SHM 纳入上市公司合并范围,对公司报告期利润产生了积极影响。

2026 年,公司将持续在产品研发创新、市场深耕拓展、管理水平提升等多方面协同发力,同时也将通过加速海外业务拓展、优化下游客户结构及提升综合运营效率等举措,进一步巩固行业地位,增强盈利能力与抗风险能力,持续以稳健的业绩表现回馈广大投资人。

### **1、夯实存储基石,持续深化性能和性价比优势,保持行业领先性**

报告期内,公司实现存储系列芯片营收 17.87 亿元,同比上升 26.10%,毛利率 29.54%,同比下降 5.07 个百分点,出货量 71.83 亿颗,同比上升 6.06%。存储作为公司产品矩阵的基石,处于重要的战略地位,报告期内产品线具体进展如下:

#### **(1) NOR Flash: 持续进行工艺迭代,巩固行业领先优势**

公司目前该产品线已实现双工艺、多制程、全容量等完善的产品矩阵。公司 NOR Flash 产品采用 SONOS (电荷俘获)及浮栅 (ETOX) 工艺结构,提供了 512Kbit~1Gbit 容量系列,覆盖 1.1V~3.6V 操作电压,具备低功耗、高可靠性、快速擦写和快速读取的优异性能。报告期内:

1) 成本方面,公司新一代 SONOS 平台下 40E (40nm Enhance Platform) 以及 ETOX 平台下 4Xnm 制程的系列产品已量产出货,使得公司领先的性能及性价比优势可持续保持;2026 年,公司将持续拓展 SONOS 工艺平台的容量上限;

2) 产品矩阵方面,公司已实现 SONOS 和 ETOX 双工艺平台全容量系列的

产品覆盖，可以为客户提供低电压、低功耗和高可靠性的产品供应和服务支持；

3) 客户方面，公司产品已在消费电子领域构建了一定的品牌力，同时，公司重视提升在高端工业、白电、PC、通讯和汽车等领域的市场拓展和产品推广。报告期内，公司 256Mbit~1Gbit 大容量 NOR Flash 已成功导入 PC、服务器等领域的大客户；

4) “AI+”浪潮涌现为公司众多系列的通用产品提供新型需求，公司为各类 AIoT 等端侧应用客户提供满足其存储需求的产品。

### **(2) EEPROM：高可靠性产品覆盖车载和工业，低功耗领域持续领先**

公司 EEPROM 产品线目前已覆盖 2Kbit~4Mbit 容量，操作电压覆盖 1.2V~5.5V，主要采用 130nm 及 55nm 工艺制程，其中 P24C/P25C 系列产品擦写次数可达 1000 万次、数据保持时间可达 100 年，具有高可靠性、体积小、性价比高等优势，公司已于手机摄像头、其他消费类及周边等获取了较为稳定的客户基础，且具备一定规模的市场份额，同时，持续拓展在工业控制、汽车电子、通讯等领域的市场份额。报告期内：

1) 公司在巩固手机摄像头等优势领域份额的基础上，抓住运动相机、电话手表等摄像头相关的新型市场需求的兴起，以及 1.2V 低电压产品跟随主控更新换代的机会，持续夯实在摄像头市场的领导地位，扩大市场份额；

2) 公司紧跟三表智慧化发展趋势，挖掘海内外三表市场应用，满足客户即时方案需求；

3) 公司持续拓展车身领域应用，目前已成功导入车身域控、电机控制、电池 BMS、车载中控、娱乐系统等汽车电子的应用场景，后续将继续有效拓展对应领域及客户份额；

4) 公司 SPD 及 TS 产品稳步进行市场拓展，已经完成了多家客户的批量出货，同时也在持续推进重点大客户的送样。

### **(3) 2D NAND：存储战略纵向延展，SHM 双向协同，抢占先机**

公司于 2025 年 11 月以现金收购方式，实现对 SHM 的间接控股。SHM 拥有成熟的业务体系与独立经营能力，其在韩国和日本的工程中心以及全球多地的销售办事处，已构建起完善的全球销售网络。公司在固件算法开发、存储芯片测试方案等方面具备核心竞争力，其 2D NAND 及其衍生产品凭借高可靠性和快速读

取特性，面向工业及车载领域已通过全球多家大型客户的平台验证。SHM 与公司核心的业务形成协同效应，公司通过此次外延并购，成功拓展了自身业务边界，实现优势互补，极大地丰富了公司的产品线，进一步强化了其在存储器芯片领域的技术实力与市场竞争力，为公司带来了更强的综合竞争水平和广阔的成长空间。

2026 年，公司将聚焦存储业务，纵深推进存储战略布局：1)持续挖掘 SONOS 工艺平台在低功耗、高可靠性方面的潜力，提升产品竞争力，拓宽在可穿戴、物联网等领域应用，同时做好下一代 SONOS 工艺技术储备；2) 实现基于 ETOX 浮栅技术的 NOR Flash 产品量产完备化，覆盖通讯、工业控制、AI 边缘计算等市场，满足商用、工控、车载等多维度客户需求；3) 优化车规产品开发与验证体系，推动车载存储产品规模化应用，实现汽车业务收入占比翻倍增长，并提前规划高带宽存储产品；4) 依托对诺亚长天的收购整合与技术协同，将 2D NAND Flash 打造为第三增长极，与 NOR Flash、EEPROM 形成完整覆盖，完成利基非易失性存储战略布局。

## 2、“存储+”业务协同效应显现，平台化发展构筑系统级方案解决能力

得益于“存储+”战略的稳步实施，MCU 产品及 Driver 等模拟新品不断推出，得到市场持续认可，市场份额有效提升，带动了公司整体收入水平持续新高。报告期内，公司“存储+”产品线实现营业收入 5.32 亿元，同比增长 37.91%，毛利率 24.42%，出货量 14.63 亿颗，同比上升 68.18%，成为公司新的增长引擎，也充分验证了公司的产品创新能力和市场竞争力。报告期内，产品进展如下：

### (1) MCU：持续完善产品家族图谱，逐步迈入更高阶产品市场

公司基于领先工艺和超低功耗与高集成度自有设计的存储器优势，布局 ARM Cortex-M 内核系列 32 位通用型 MCU 产品。截至 2025 年末，公司已成功量产 M0+及 M4 的五大产品系列、超两百款 MCU 产品，覆盖 55nm、40nm 工艺制程，产品支持 24MHz~170MHz 主频、24KByte~512KByte Flash 存储容量、USB/CAN/SDIO/Ethernet 等主流接口，以及 20~100IO 的多种封装形式，形成宽电压、低功耗、-40℃~105℃/125℃高温等高质量、高可靠性、高性价比通用产品矩阵。产品主要应用于智能家居、小家电、白电、BMS、无人机、电机驱动、

工业、健康管理等下游领域，国产替代趋势下持续导入空间较大。2022 年出货至今，总出货量已突破 24 亿颗。报告期内,该产品线进展如下：

1) 公司基于 ARM 内核的 M0+系列 MCU 在取得大批量量产和众多客户认可的基础上，持续迭代，不断推出高性价比、低功耗产品系列。目前 M0+系列 MCU 已涵盖从 24MHz 到 72MHz 主频，从 12KByte 到 256KByte 片内 Flash，从 5pin 到 64pin，超 200 个产品，为客户需求提供精准匹配，在消费，工业，家电市场均实现大批量稳定供货；

2) 公司基于 ARM 内核的 M4 MCU 产品目前已有 28 颗料号量产出货，主频高达 170MHz，片上 Flash 高达 512KByte，涵盖主流通用 M4 内核 MCU 应用。其中，高性价比 Y32F410 系列具备丰富的软件资源，如 2\*OPA，2\*CMP；12 位、3MSPS 高速 ADC；定时器和 PWM 独立通道总数高达 36 个；64PIN 封装的产品，GPIO 可达 60 个；Dual-Bank 128K Flash，支持 OTA 时边读边写。产品受到舞台灯（多 PWM）、电机控制、手持云台、雷达、TFT 屏幕驱动、游戏手柄等诸多应用领域客户认可，已进入小米、美的、云鲸等品牌客户供应链体系，协助客户实现低成本、高性能控制；

3) 公司保持着在 MCU 产品线上的持续投入，逐步拓展更高端市场份额，不断满足高端客户和市场需求，持续推出白色家电与电机控制系列，基于空调、洗衣机、冰箱等白电的变频、电机、主控及触摸、HMI 显示等多模块推出对应系列产品。报告期内，对应领域 M0+和 M4 多系列已量产，主频覆盖 48MHz~170MHz，工作电压覆盖 1.7V~5V，具备 12KByte~512KByte Flash 及 1KByte~144Kbyte SRAM，集成 UART/SPI/I2C 等接口，支持 26~86IO，温度范围支持-40~105℃，支持多种封装形式，应用场景包括家电主控，触摸控制、变频电机及压缩机、PFC、旋钮屏和双变频等高端场景；

4) 公司在持续提升性能和成本优势的同时，不断扩大自身的软件及方案设计优势，完善配套工具库、软件包等，同时重视 FAE 团队的综合素质培养及服务响应效率提升，为客户提供完善的技术支持。

## **(2) Driver: 形成对存储器产品线和微控制器产品线的有效协同**

公司该产品线主要应用在手机摄像头模组，儿童电话手表、运动相机等各类

终端，打开了更多新的市场空间。目前公司多款开环的音圈马达驱动芯片产品均已量产出货。该系列产品可有效降低产品功耗，缩小芯片面积，以顺应各类智能终端轻薄化的发展趋势。报告期内,该产品线进展如下：

1) 依托公司 EEPROM 产品线协同发力，VCM Driver 产品线在开环驱动市场已斩获一定市场份额，成功导入多家品牌手机客户。报告期内推出新一代开环驱动产品，整合底置、中置等多款料号，简化客户选型流程，实现产品型号高效适配；

2) 报告期内，公司推出面向主摄长焦及潜望镜头的新一代 OIS（光学防抖音圈马达驱动）芯片，现已实现规模化大批量量产；

3) 公司规划推出适配长焦相机、Vlog 相机等终端的 OIS 芯片，以满足长行程、防抖、高清成像等更严苛的产品需求；

4) 报告期内，公司推出首款闭环驱动芯片，可满足大行程应用需求，适配折叠屏、潜望式摄像头等高端应用场景；

5) 依托产品线协同推进 MCU 预驱等产品出货，助力公司 MCU 产品在电机市场的份额持续拓展。

2026 年，公司将深入发挥嵌入式存储基因优势，打造差异化的高集成度产品。不断丰富 MCU 产品矩阵，覆盖从低成本应用到高性能、低功耗及功能安全需求的多元化市场。产品定义将紧密跟随白电及生活电器、人机交互、电机控制、电源管理、智能硬件、泛消费类等终端应用的智能化、跨界融合趋势，提升客户开发的便利性。在模拟领域，将确保系列音圈马达驱动产品通过头部模组厂及终端客户的严格认证，实现向主流手机及摄像头模组厂商的稳定批量供货，确立在细分市场的领先地位。此外，规划其他新品类模拟芯片的研发，与存储器和 MCU 产品形成系统级方案，提升单机价值量，使“存储+”战略得以在更复杂的系统层面落地，同时与存储基石实现更深层次的协同，共同构建产业生态圈，强化公司在产业链中的主导地位。

### **3、多维协同全球拓展，外延收购 SHM 强化存储核心竞争力，打响全球范围品牌力**

为增强公司在存储器芯片领域的核心竞争力，进一步丰富产品线，本报告期，公司通过现金收购方式，控制珠海诺亚长天存储技术有限公司 51% 股权。同时，因 SHM 于本报告期新纳入上市公司非同一控制下的合并范围，分别对本报告期营业收入贡献约 2.1 亿元、对归属于母公司所有者的净利润贡献约 1,400 万元、对归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润贡献约 1,400 万元。

SHM 为一家注册在中国香港的半导体企业，专注于提供中高端应用的高性能 2D NAND 及衍生存储器（SLC NAND，eMMC，MCP）产品及方案，核心竞争力为固件算法开发、存储芯片测试方案、集成封装设计、存储产品定制。SHM 在韩国和日本设有工程中心，并在亚洲、欧洲、北美等地设有销售办事处，在全球范围内建立了较为成熟的销售网络，可为客户提供高质量闪存解决方案，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。在这个背景下，公司将从技术、产品、市场三个关键维度中与 SHM 形成协同作用。

### **（1）技术协同**

SHM 研发团队深耕行业多年，在固件算法开发、存储芯片测试方案等方面积累了深厚的技术经验。依托自主研发的 Final Test 程序软件，SHM 建立了严格的测试体系，涵盖高低温及电压波动的环境应力测试以及高温老化筛选，确保芯片分类的精准度与长期稳定性。此外，SHM 的固件算法聚焦性能优化与数据安全，有效提升存储效率，为工业控制、汽车电子等场景提供端到端数据可靠性保障。

公司作为集成电路设计企业，拥有较强的集成电路产品的自主研发设计能力，SHM 在产品性能优化、核心量产流程建立与系统优化等方面积累了丰富的产品工程及制造工程能力，双方在设计及工程能力方面有效互补。

### **（2）产品协同**

SHM 的核心产品 SLC NAND 及 eMMC 产品技术成熟，性能突出，在业内形成了较好的市场口碑。根据 TrendForce 等市场调研数据，SHM 为 2024 年全球第四大 SLC NAND 厂商，仅次于铠侠、美光和华邦。公司主营产品为 NOR Flash、EEPROM、MCU 和 VCM Driver 等，标的公司的主营产品为 SLC NAND、eMMC、MCP 等，双方在主营产品实现有效互补，可形成完整的非易失性存储产品布局。

### **（3）市场协同**

SHM 凭借较为成熟的全球化销售网络，服务的终端客户覆盖消费、工业、汽车、通信等多个下游核心领域，头部客户包括博世、搜诺思、思科、萨基姆等多家欧美知名企业。因其产品具有高性能品质，SHM 与客户达成长期合作信任，在行业内形成了较好的市场口碑。公司主营业务收入主要来源于中国市场，而 SHM 主营业务收入主要来源于海外市场，双方在销售渠道方面有效互补，可形成覆盖全球范围的销售网络。

#### **4、高研发投入赋能产品创新，专利与人才并驱强劲发展动能**

公司高度重视研发投入，致力于通过持续创新巩固市场地位并开拓新的业务增长空间。报告期内，公司投入研发费用 2.97 亿元，占营业收入的比例达到 12.82%。主要系公司积极扩充研发人员团队，为各类研发项目注入充足人力支持，有效的推动了公司新产品线的规划、开发和量产。

公司研发人员达到 318 人，占公司总人数比例超过 55%，其中博士研究生 5 人，硕士研究生 121 人，本科学历 180 人，本科及以上学历占比超过 96%。高素质的研发团队为公司技术创新和产品升级提供了坚实的人才保障，进一步强化了公司在行业内的核心竞争力。

此外，公司拥有多项自主知识产权和核心技术，并形成了有规划、有策略的专利布局。2025 年，公司积极开展集成电路布图设计专有权与发明专利的申请工作，公司特设知识产权工程师岗位，以协助设计研发人员挖掘、撰写专利申请技术文件，并积极组织知识产权相关培训。通过多种知识产权类型交叉保护，公司构建了一定的技术壁垒，保障了公司核心技术成果的自主性和完整性。2025 年度，公司取得 15 项发明专利，5 项实用新型专利授权，新提交 27 项发明专利，1 项发明（PCT）专利，3 项实用新型专利申请，取得 2 项软件著作权，15 项集成电路布图设计登记，建立起了完整的自主知识产权体系。

2026 年，公司将继续优化内部技术职级与晋升通道，通过核心项目历练，加速骨干员工的成长，形成坚实的中坚力量。深化与重点高校的产学研合作，完善应届生“导师制”培养计划，为公司持续注入新鲜血液。

此外，结合公司业绩增长，公司将滚动实施股权激励计划，激发奋斗精神和组织活力，也使员工感受到公司成长带来的回报和个人成就的提升。

## 二、贯彻大客户和海外客户战略，重视海外供应链体系建设和销售网络搭建

### 1、海内外多点协同，坚定布局全球销售网络和供应链体系

2025年，公司延续2024年积极进取的市场拓展态势，围绕“巩固国内根基、加速全球布局”的战略方向，在海内外市场取得了进展与突破。国内市场，公司持续深化本地优势，各产品线协同效应持续显现。依托已经建立起的稳固的客户网络，公司NOR Flash、EEPROM、MCU、Driver等产品协同赋能，实现客户资源的高效共享和深度挖掘。报告期内，公司在消费电子、工控、通讯等核心领域拓展了新的客户与终端市场，同时对现有客户的合作广度和深度进行了有效延伸，推动了出货量的稳步增长。与此同时，公司持续推进海外业务布局，实现了在日本、韩国、美国等多家的知名大客户导入，产品应用领域涵盖消费、工控、光伏及车载，增强了在全球市场的影响力。

为加快海外供应链的实质性建设，满足国际客户的本地化供应需求，提升地缘风险应对能力，公司持续布局供应链战略合作。未来依托海外并购的契机，公司将基于已有的销售网络继续大力拓展海外业务版图，组建国际化业务团队，针对海外大客户制定专属拓展计划。同时通过参与国际行业展会、设立海外销售及技术支持中心等方式，提升普冉在全球的品牌影响力和市场地位，实现从本土企业向国际化半导体公司的跨越。

### 2、品牌创新力获权威认可，彰显市场地位与品牌价值

2025年，公司积极参加各类展会，加大品牌曝光力度，获得了多家主办方及评选单位的各类奖项，增强了公司的行业影响力：

参展IIC2025，荣获“2025年度技术突破IC设计公司”；

参加2025慕尼黑上海电子展，展示了各条产品线最新研发成果及解决方案；

参加浦东开发开放35周年举办的“2025年浦东新区突出贡献企业答谢活动”，荣获浦东市人民政府颁发的“2024年度浦东新区创新创业奖”；

参加由中国集成电路设计创新联盟、中国汽车芯片产业创新战略联盟等举办的第十二届汽车电子创新大会(AEIF)，荣获2025“汽车电子·金芯奖-卓越产品奖”；

参加第 22 届 elexcon 深圳国际电子展暨嵌入式展,主办方联手电子发烧友网,共同举办“2025 半导体市场创新表现奖”评选,公司荣获“年度优秀 AI 芯片奖”;

2025 第五届中国 BLDC 电机产业链优秀企业年度评选,公司 PY32F410 系列产品荣获“电机卓越主控芯片”奖项;

参加由半导体投资联盟与爱集微联合打造 IC 风云榜 2026 半导体投资年会,荣获“年度半导体上市公司领航奖(存储芯片)”;

公司两款芯片产品成功入选上海市经信委发布的《2024 年度上海市创新产品推荐目录》。

### **3、战略投资赋能生态,产业协同蓄力长远**

报告期内,公司于资本运作与产业布局层面持续发力,基于过往的基金投资及战略配售,持续拓展业务边界、优化产业生态。

公司以自有资金参投华大九天 A 股 IPO 战略配售以来,获得了可观的投资收益,同时形成了深度战略业务合作关系。同时,公司参投的季丰电子保持良好的营运表现,持续为公司提供优质服务,发挥着上下游产业链协同效应。

其他投资方面,公司参投的上海渠清如许创业投资合伙企业(有限合伙)以及上海海望合纵私募基金合伙企业(有限合伙)稳步推进各项工作。通过与这些专业投资机构合作,探索潜在的规模化成长路径,实现产业与资本的深度协同。

展望未来,公司将继续围绕主营业务核心,秉持业务与资本协同共进的发展理念,灵活运用资本市场工具,持续挖掘优质投资机会,为公司的长远发展培育新的增长点,不断提升公司在行业内的综合竞争力与市场影响力。

### **三、精耕细作控成本,筑牢供应链根基,夯实高质量发展基本盘**

成本管控与供应链安全是企业实现稳健经营、高质量发展的重要基础。2025 年度,公司坚持“精细化管理、全流程管控”的理念,持续深化成本管控工作,不断升级供应链体系,有效提升了企业运营效率与抗风险能力,为公司高质量发展筑牢了坚实基本盘。

#### **1、构建全流程成本管控体系,多措并举实现降本提质增效**

2025 年度,公司密切关注市场动态与行业周期变化,结合自身经营实际,

严格落实既定成本管控策略，构建起从产品设计、生产制造到采购管理、库存管控的全流程、一体化成本管控体系，通过多维度、多举措发力，实现降本增效，提升企业经营效益。

在产品设计环节，坚持“性能与成本兼顾”的原则，基于 SONOS、ETOX 双工艺架构，在保障产品性能满足市场与客户需求的前提下，全力推进芯片制程缩进工作。通过研发团队的技术攻关与设计优化，公司 SONOS 工艺的第三代 40E 平台产品已顺利推出，同时，公司 ETOX 工艺最新一代制程平台已达 4Xnm，并实现了部分产品线的批量出货。双平台新一代制程产品的成功推出，有效降低了单位芯片的原材料消耗，提升了晶圆利用率，从源头实现产品降本，为公司保持了行业持续的竞争优势。

在生产制造环节，公司与晶圆厂保持深度战略合作关系，双方协同推进工艺水平提升与生产流程优化，2025 年各产品线良率均实现持续提高，有效降低了生产制造成本与产品损耗，提升了生产效率。

在采购管理环节，公司成立专业的采购评审委员会，依托专业团队实现采购环节的精细化、规范化成本管控。同时，公司持续加强与核心供应商的战略合作，凭借长期稳定的合作关系与规模化采购优势，在关键原材料采购价格上争取有利条件，有效控制采购成本，保障采购效率与质量。

在库存管控环节，公司持续优化升级系统流程，完善库存管理体系，通过报表系统实现运营数据精细化、高效化管控。

## **2、升级供应链保障体系，筑牢产业发展支撑基石**

公司与国内主要晶圆代工厂、封测厂保持紧密的战略合作关系，从技术研发、产能保障、质量管控等多维度深化合作广度与深度，确保供应链产能的稳定与安全。2025 年度，公司全面贯彻“QCDST”供应商管理机制，从质量（Quality）、成本（Cost）、发货（Delivery）、服务（Service）、技术（Technology）五个维度对供应商进行全面、系统的考核与评估，持续推进既有产品与新产品领域的供应商考评与引入工作，积极拓展供应商资源，完善海内外供应商布局，引入多元供应商参与公司供应链体系建设。有效提升了公司的产能保障能力与供应链稳定性，也增强了公司在采购环节的议价能力，有效降低采购成本，进一步筑牢供应链根

基。

同时，公司结合市场需求变化与自身业务发展规划，提前与晶圆代工厂等核心合作方开展产能扩充规划工作，通过强化数字化运营能力、推进生产运营精细化管理，提升产能调配效率与灵活性。既能够满足公司业务规模快速扩张的产能需求，又能有效应对市场景气度变化带来的产能波动，提升公司供应链的抗风险能力与市场适应能力。

#### **四、人才强企筑根基，激励培养双驱动，激活企业发展内生动力**

人才是企业发展的第一资源，是推动企业技术创新、高质量发展的核心动力。2025 年度，公司持续深入推进“人才强企”战略，将人才建设与企业发展战略深度融合，通过完善全方位激励体系、构建立体化培养生态，不断优化人才结构，激发组织活力与员工创造力，为公司高质量发展提供了坚实的人才支撑与内生动力。

##### **1、完善全方位激励体系，激发组织活力**

2025 年 12 月末，公司员工总数达 574 人，新增人员合理分布于芯片设计、工艺研发、测试验证、市场拓展、运营管理等多个关键岗位，其中研发团队规模进一步扩大，为公司技术创新与产品升级注入了新鲜血液，持续强化了公司在存储芯片及“存储+”领域的研发实力与市场拓展能力。

公司不断完善绩效奖励制度，构建科学合理、贴合企业实际的绩效考核指标体系。2025 年完成对绩效考核指标的全面梳理与优化，突出业绩导向与价值创造，将各岗位关键绩效指标（KPI）与公司整体经营业绩、战略发展目标紧密挂钩，对表现优秀的员工给予及时、丰厚的奖励，营造了奋勇争先、比学赶超的工作氛围，有效激发了员工的工作热情与创造力。

结合市场薪酬变化趋势与行业薪酬水平，公司于 2025 年完成薪酬结构优化调整，有效提升研发人员平均薪酬，充分体现了公司对研发人才的高度重视与价值认可，确保公司在行业内具备强劲的薪酬竞争力，有效吸引和留住行业优秀人才，稳定核心人才队伍。

公司持续推进股权激励计划，2025 年在过往激励基础上进一步扩大激励范围，各期激励计划的激励对象覆盖率已达全体在职员工的 80%以上。通过股权激

励，将更多员工的个人利益与公司长远发展紧密绑定，构建起企业与员工的利益共同体、发展共同体，有效激发了员工的主观能动性与创造性，增强了员工对公司的归属感与忠诚度。

## **2、构建立体化人才，培养生态，深化校企合作**

基于公司业务发展与研发创新的实际需求，围绕“人才内生与能力提升”核心战略，2025年，公司重点推进应届生导师带教项目、校企联合培养计划及管理 ability 发展项目三大专项，针对不同职能、不同层级员工开展分层、分类的精准化培训。2025年度，全年开展各类培训50余场，覆盖员工超1200人次，其中技术培训、管理培训占比合理，培训覆盖新员工入职、专业技能提升、通用能力拓展、管理能力进阶等多个维度，培训内容涵盖半导体前沿技术、先进工艺制程、项目管理实战、市场营销策略等核心领域，有效提升了全体员工的专业素养与综合能力，为公司高质量发展提供了坚实的能力支撑。

### **(1) 应届生导师带教项目：系统化助力新人融入与成长**

本年度全面升级“企业导师带教”机制，针对应届毕业生实施“一对一”带教模式，覆盖100%新入职应届生。项目通过制定个性化带教计划、定期复盘辅导、实战项目跟练等形式，加速其专业技能积累、业务理解与团队协作能力提升。参与带教的应届生转正合格率达100%，半年内独立承担项目任务比例超过80%，人才成长周期显著缩短。

### **(2) 深化校企合作：共建芯片领域人才培养生态**

在2024年与名校合作基础上，2025年进一步拓展校企联合培养的广度与深度，开展研究生定向培养、课题共研、技术攻关等合作。年内共有4名联合培养研究生进入公司参与实际项目，其中1人已获得发明专利授予。校企合作不仅为公司输送了高潜力技术人才，也为行业前沿技术的探索与储备提供了持续动力。

### **(3) 通用能力与管理能力发展项目：全员赋能，提升组织效能**

针对全公司员工，重点推出“通用能力与管理能力发展项目”，涵盖自我管理、管理他人、团队管理等三大主题，通过项目管理、沟通协作、时间管理、报告撰写等课程，提升员工职业素养与工作效率。针对管理者开展团队管理、绩效辅导、授权激励等培训，强化领导力与组织效能。

#### **(4) 技术培训继续深化：设计质量提升培训**

在 2025 年度培训计划框架下，公司进一步聚焦芯片设计质量提升，特别增设“设计质量提升系列课程”，从质量意识、设计方法、实战经验三个维度构建系统化技术培训体系，推动全流程质量能力内化。

本系列课程已覆盖芯片设计、验证、测试及质量相关岗位员工超过 200 人，通过系统化质量培训，公司初步构建了跨部门的质量协同语言与工作共识，有效支持了公司产品设计质量目标的实现。

### **五、透明沟通传价值，多元互动聚共识，合力提升资本市场认同度**

投资者关系管理是企业治理的重要组成部分，是实现企业与资本市场良性互动、提升企业市场认同度的重要途径。2025 年度，公司始终秉持“透明沟通、价值共享、尊重投资者、回馈投资者”的理念，将投资者关系管理工作与公司生产经营、战略发展深度融合，通过开展多元化的投资者互动交流，全方位、多角度、及时准确地向资本市场传递公司经营信息与发展价值，进一步提升公司在资本市场的透明度与形象，增强市场认同与投资者信心。

#### **1、定期报告深度交流，高频互动强化机构信任**

围绕定期报告披露，公司积极组织多场业绩说明会，2025 年共参与或召开 3 场业绩说明会，包括 2024 年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、上海辖区上市公司 2025 年三季报集体业绩说明会。公司管理层亲自出席业绩说明会，与广大投资者进行充分、透明的互动交流，针对投资者关注的存储芯片市场趋势、“存储+”战略推进情况、外延收购进展情况、业绩变动原因、未来发展规划等核心问题，给予详实、专业、准确的解答，有效加深了个人投资者与机构投资者对公司经营状况、发展战略与未来前景的理解与认同。

同时，公司保持高频次、多形式的机构投资者交流，2025 全年累计接待 293 家机构投资人调研，机构类型覆盖保险公司、基金公司、海外机构、证券研究所、私募机构等各类资本市场主体。通过实地调研、线上交流、一对一沟通等多种形式，与机构投资者进行深度沟通，及时传递公司最新经营动态、研发成果、市场拓展情况与发展规划，持续增强机构投资者对公司的认知与信任，夯实了资本市

场合作基础。

公司积极响应相关号召，如线上发布“股东来了”活动介绍及参赛邀请入口，并在投资者平台同步发布，加强中小股东金融知识体系建设；积极参与上交所主题活动，走进ETF成分股公司活动，保障投资者权益。

## **2、创新沟通渠道矩阵，可视化呈现提升信息触达效率**

在做好电话、邮箱、上证e互动等传统沟通渠道运营的基础上，公司积极顺应资本市场发展趋势，布局新兴沟通渠道，构建起多维度、立体化、全覆盖的投资者沟通渠道矩阵，提升信息传递的效率与精准度。

公司在官方网站设置专门的投资者关系板块，整合股价信息、最新公告、投资者问答、投资者热线及邮箱等核心内容，打造投资者获取公司官方信息的权威、便捷窗口；高度重视上证e互动平台运营，建立健全投资者问题快速响应机制，对投资者提出的问题保持100%回复率，确保投资者的合理关切得到及时、准确的回应。

公司官方微信公众号作为品牌与价值传递的重要载体，定期发布公司新闻、新产品推出、战略布局、研发成果等图文内容，并同步在东方财富、同花顺等主流投资者平台发布，以多元化、通俗化的形式向投资者传递公司价值。为提升定期报告的可读性与实用性，公司在定期报告披露后，第一时间在公众号发布解读长图文，以通俗易懂的语言、直观的数据图表提炼报告核心要点，帮助投资者快速、准确把握公司季度经营状况。

2025年下半年，公司积极参与上证路演中心“科创3分钟”高管开放麦主题活动，创新采用短视频形式，集成可视化年报、董事长致辞、业绩亮点、投资者回报举措等市场关注内容，并配套发布可视化年报长图文，以更直观、更生动、更易懂的形式向投资者传递公司信息，提升了公司信息的可看性、可及性、可投性，持续提高了投资者互动质量与效率。

## **六、合规经营守底线，内控升级强治理，筑牢稳健发展安全屏障**

合规经营是企业生存发展的底线，完善的内控体系与良好的公司治理是企业实现高质量、稳健发展的重要保障。2025年度，公司聚焦战略发展目标与合规

经营要求，持续优化内部控制体系，强化内部监督与风险管理，完善公司治理结构，提升精细化管理水平，为企业稳健运营与高质量发展筑牢了坚实的制度与安全屏障。

### **1、紧跟监管政策导向，完善制度体系**

公司依据新《公司法》的修订动态，紧密跟踪《上市公司章程指引》的修订与发布情况，及时对公司内部管理制度进行更新与修订，确保公司治理与制度建设符合最新法律法规与监管要求，保障公司规范运作，维护投资者合法权益。同时，公司组织董事、高级管理人员及相关核心人员积极参加上海证券交易所等监管机构举办的合规培训活动，及时掌握最新法律法规与监管要求，提升相关人员的合规意识与履职能力，推动公司整体治理水平持续提升。此外，公司持续关注资本市场最新监管规则与发展趋势，建立健全监管信息传递机制，及时将相关信息传达至董事会及管理层，确保公司经营管理与监管政策保持高度一致，积极配合资本市场监管机制。

### **2、优化内部运营流程，提升企业运营管理效率**

在制度优化的基础上，公司围绕基础管理制度，持续优化内部运营流程，提升办公效率与管理效能。合同管理实现信息化系统全流程管控，从合同起草、审核、签订到履行、归档实现全生命周期管理，并配套制定符合内控要求与合规要求的合同模板，确保合同管理的规范化、合规化；项目管理进一步明确各阶段岗位职责与工作标准，强化项目进度、质量与成本的全流程监控，提升项目管理效率与成功率。2025年，公司引入飞书办公系统，依托其高效的沟通协作功能、专业的项目管理工具、智能的知识管理体系，实现内部沟通、工作协作、项目管理、知识共享的数字化升级，全面提升公司整体工作效率与精细化管理水平。

综上，2025年公司内部控制体系完善取得显著成效，公司治理水平、风险管理能力与精细化管理水平进一步提升。未来，公司将持续优化治理结构，强化内部审计与监督职能，不断完善内部控制体系，提升合规经营与风险管理能力，为公司战略目标的实现提供坚实的制度保障。

2025年，公司严格按照“提质增效重回报”行动方案的各项要求，统筹推进

各项工作，在战略布局、产品创新、市场拓展、成本管控、人才建设、投资者关系管理、公司治理等方面均取得了显著进展，经营质量与发展韧性持续提升。2026年，公司将继续严格落实“提质增效重回报”行动规划，并对规划执行情况进行持续跟踪、评估与优化，按照相关法律法规与监管要求及时履行信息披露义务。

未来，公司将进一步提升经营管理水平，聚焦半导体主业，以技术创新为核心，以市场需求为导向，持续强化核心竞争力，不断优化盈利能力与经营质量，推动企业实现高质量、稳健、可持续成长。同时，公司将始终坚守“以投资者为本”的发展理念，密切关注资本市场动向，结合自身业务发展现状、未来发展规划与行业发展趋势，制定并落实积极、稳定的投资者回报政策，以持续、稳定的业绩表现与价值增长，为广大投资者带来长期的价值投资回报，与投资者、合作伙伴携手共赢，共同发展。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年3月20日